

Linia produktów Magic firmy Raytech

Paweł Mrówczyński

Włoska firma Raytech, producent komponentów i akcesoriów dla linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia, poszerzył zakres produktów w dziedzinie uszczelnienia i izolacji elektrycznej. W artykule omówiono linię produktów Magic, oferowaną na polskim rynku przez firmę Elettronica Italiana.

Nowa linia produktów firmy Raytech wykonana jest z materiału składającego się głównie z siatki łańcuchów polimerowych. Płyn Magic Fluid dostarczony jest w torebce, zawierającej dwa składniki – Magic Fluid i aktywator. Są one oddzielone wyjmowaną przegrodą.

Charakterystyka

Zastosowanie płynu jest proste i szybkie. W momencie zmieszania rozpoczyna się reakcja chemiczna i następuje żelowanie. Reakcja ta nie wymaga żadnych specjalnych warunków i jest niezależna od temperatury. Nowa technologia różni się znacząco od używanych obecnie technik izolowania metodą zalewania. Pozwala na uszczelnianie i izolowanie wszystkich połączeń (stopień szczelności wyższy od IP68), także na dowolnej głębokości, chroniąc jednocześnie przed korozją w szybki i skuteczny sposób.

Używany materiał jest ponadto całkowicie nietoksyczny.

Zastosowania

Linie produktów Magic znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

- uszczelnianie puszek rozgałęźnych,
- uszczelnianie muf kablowych,
- uszczelnianie kanałów kablowych i rur instalacyjnych,
- zalewanie wszelkich innych połączeń

Magic Fluid i Magic Joint

W kolejnych wydaniach magazynu ELEKTROSYSTEMY zostaną opublikowane artykuły na temat Magic Fluid i Magic Joint.



Rys. 1. Technologia Magic Fluid pozwala na uszczelnianie i izolowanie wszystkich połączeń (stopień szczelności wyższy od IP68)



Rys. 2. Jednym z zastosowań może być uszczelnianie muf kablowych

przewodów i kabli w ziemi i wodzie powietrznej,

- zabezpieczanie antykorozyjne płytek elektronicznych i połączeń śrubowych.

W momencie, gdy proces żelowania rozpoczął się produkt ma bardzo niewielką lepkość. W związku z tym z łatwością dociera do wszystkich zakamarków uszczelnianej obudowy, skutecznie usuwając powietrze. W trakcie tężenia nie pojawia się żaden wzrost temperatury (w przeciwieństwie do procesu tężenia żywicy). Po krótkim czasie (ok. 10 min. przy 20°C) złącze jest gotowe zarówno pod względem skuteczności dielektrycznej (ta jest uzyskiwana nawet, gdy produkt jest jeszcze w stanie płynnym), jak i właściwości mechanicznych.

W skład produktów linii Magic wchodzi:

- Płyn Magic Fluid – służy do zalewania każdego typu osłon połączeń,
- kompletne połączenie Magic Joint – zawiera płyn i prefabrykowaną obudowę.

Paweł Mrówczyński

Autor jest pracownikiem firmy EL-IT



KONTAKT

Elettronica Italiana Sp. z o.o.

ul. T. Nocznickiego 31A
01-918 Warszawa
tel. (22) 896 80 30; 424 73 83
fax (22) 834 61 96
e-mail: biuro@el-it.pl
www.el-it.pl